

IBM Power® System S812LC (8335-GTB) クイック・インストール・ガイド

注意と手順をすべて読んでから、システムおよびその部品での作業を開始してください。

システムおよび部品に対して作業を行うときは、静電気の放電 (ESD) の正しい手順を使用してください。IBM では、装置に対する考えられる損傷を防ぐために手袋と ESD リスト・ストラップの着用をお勧めします。

8335-GTB システムに関する情報は、IBM Knowledge Center でオンラインで入手可能です。

<https://ibm.biz/QR8335-GCB>

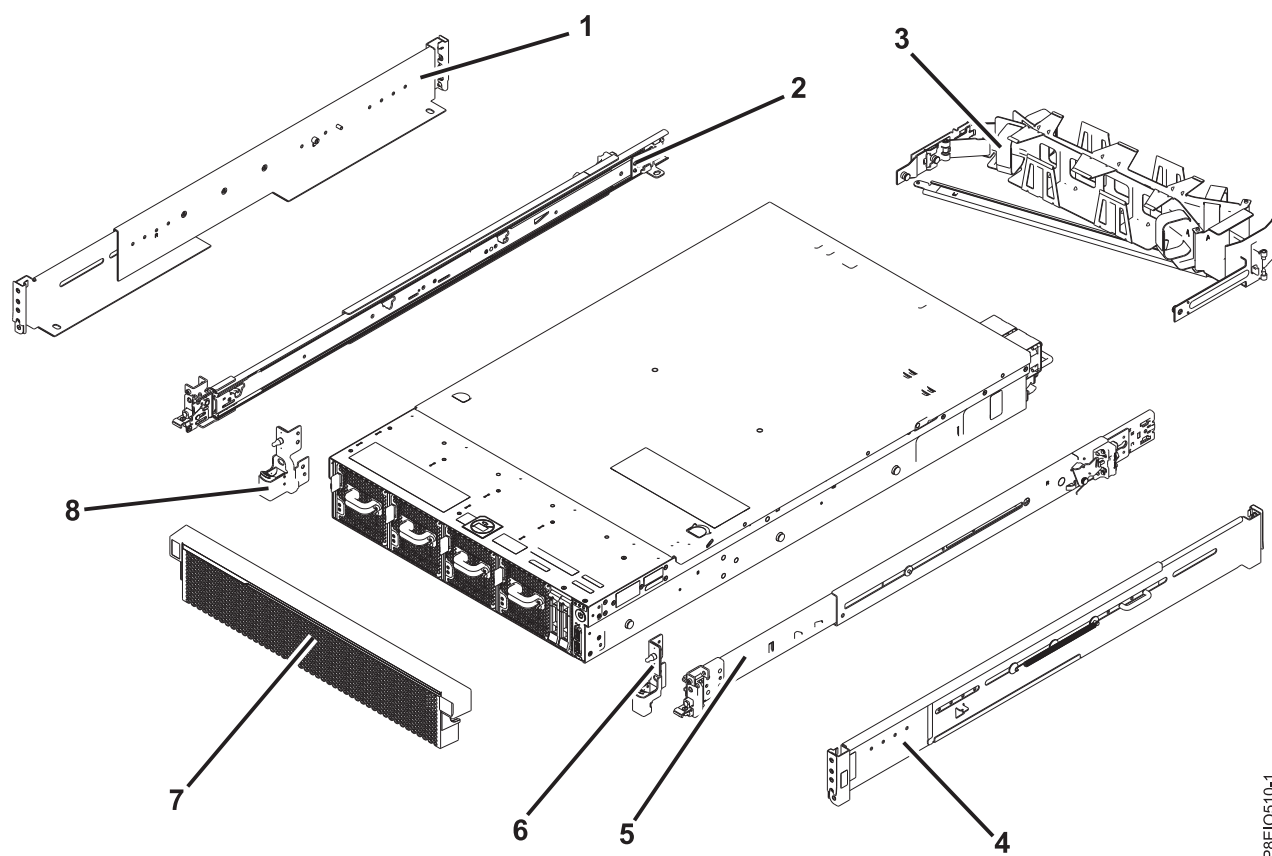


8335-GTB の部品

この情報は、現場交換可能ユニット (FRU) の部品番号を見つけるために使用します。

発注する部品の部品番号を特定したら、Advanced Part Exchange Warranty Service にアクセスしてください。登録が必要です。部品番号を特定できない場合には、Contacting IBM® service and support にアクセスしてください。

ラック最終アセンブリー



P8EIO510-1

図 1. ラック最終アセンブリー

表 1. ラック最終アセンブリーの部品番号

索引番号	部品番号	アセンブリー当たりのユニット数	説明
1	45W8836	1	固定レール・キット - 左右の固定レールおよび取り付けねじが含まれています
2	00E4260	1	スライド・レール・キット - 左右のスライド・レールと取り付けねじを含んでいます。
3	74Y9063	1	ケーブル・マネージメント・アーム・アセンブリー
4	45W8836	1	固定レール・キット - 左右の固定レールおよび取り付けねじが含まれています
5	00E4260	1	スライド・レール・キット - 左右のスライド・レールと取り付けねじを含んでいます。
6		1	米国電子工業会 (EIA) ブラケット (右側)
7	00E4688	1	ベゼル
8		1	EIA ブラケット (左側)

システム部品 (空冷システムおよび水冷システム)

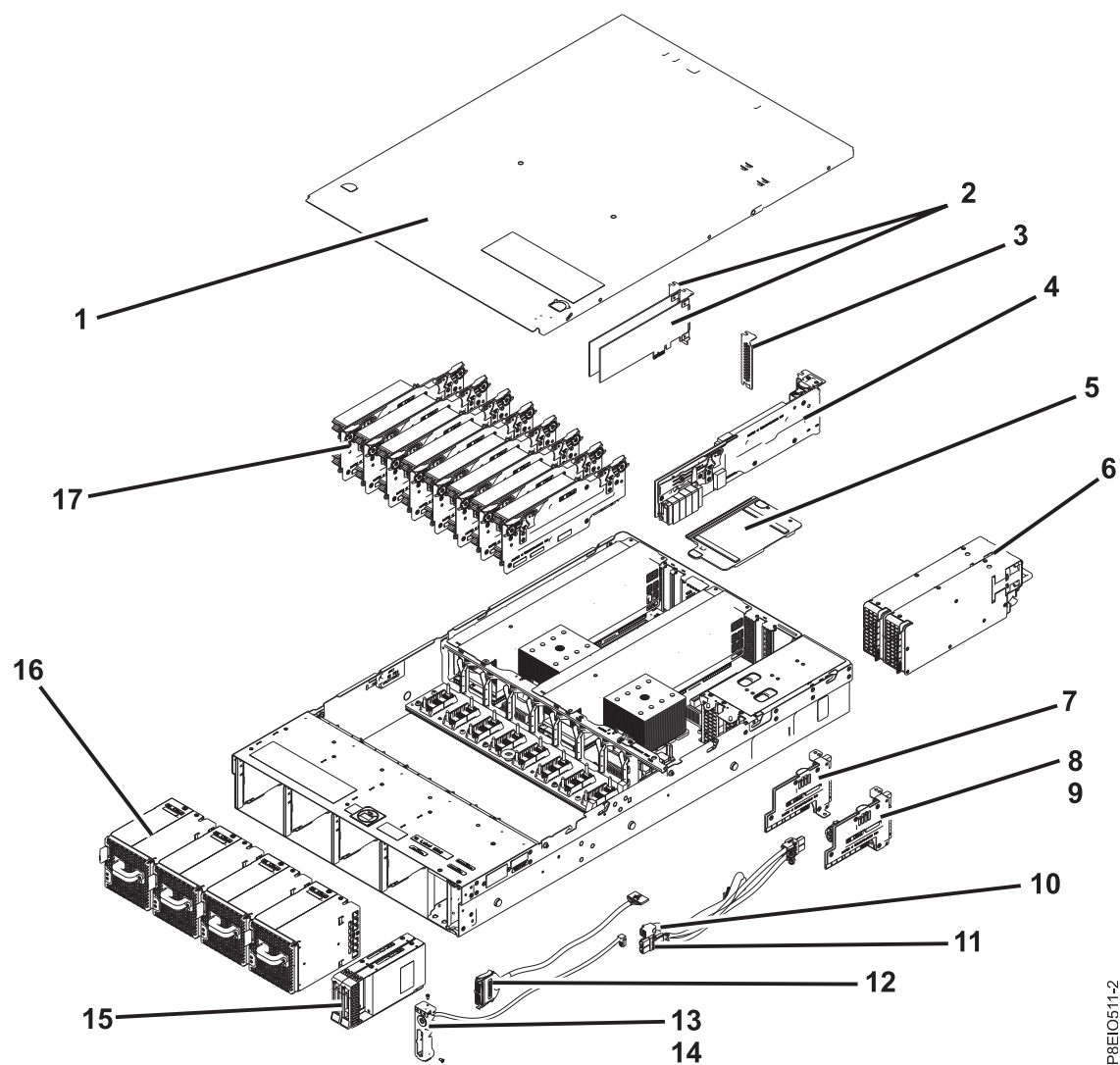


図 2. システム部品 (空冷システムおよび水冷システム)

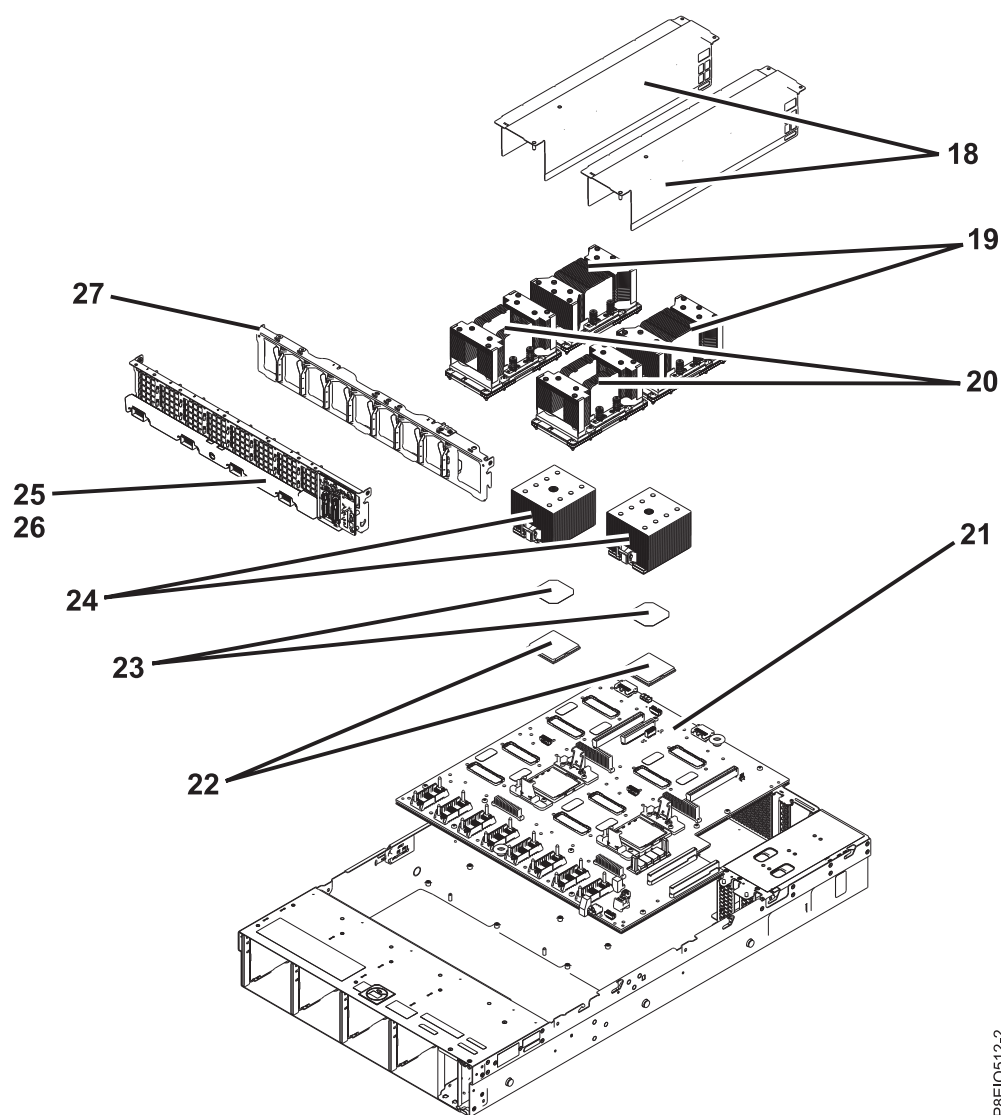
表 2. システム部品 (空冷システムおよび水冷システム)

索引番号	部品番号	アセンブリー当たりのユニット数	説明
1		1	上面カバー・アセンブリー
2		2 - 3	PCI アダプター。アダプターのフィーチャー・タイプを使用して、8335-GTB 用の PCIe アダプターで FRU 番号を見つけてください。
3	46K5109	1 - 2	PCI フィラー
4	00E4574	1	ベースボード管理コントローラー (BMC) カード
5		1	電源ライザー・エア・バッフル
6	01AF370	2	電源装置
7	00E4705	1	時刻バッテリー・スロットのない電源ライザー

表 2. システム部品 (空冷システムおよび水冷システム) (続き)

索引番号	部品番号	アセンブリー当たりのユニット数	説明
8	00E4704	1	時刻バッテリー・スロットがある電源ライザー 注: この電源ライザーの部品番号には時刻バッテリーは含まれません。時刻バッテリーは CR2450N リチウム・バッテリーです。
9		1	時刻バッテリー
10	00E4482	1	ディスクおよびファン・シグナル・ケーブル
11	00E4481	1	ファン電源ケーブル
12	00E4550	1	コネクタ付きの前面 USB ケーブル
13	00E5189	1	電源スイッチおよび電源スイッチ・ケーブル
14		2	ねじ
15	900E4252	2	ドライブ・フィラー
	00LY266	2	1 TB ディスク・ドライブ
	00LY418	2	2 TB ディスク・ドライブ
	00LY409	2	480 GB ソリッド・ステート・ドライブ
	00LY411	2	960 GB ソリッド・ステート・ドライブ
	00LY423	2	1.9 TB ソリッド・ステート SATA ドライブ
	00LY438	2	3.84 TB ソリッド・ステート・ドライブ
16	00E4256	4	ファン
17	00E4251	8	メモリー・ライザー・フィラー
	00E4498	8	メモリー・ライザー
	78P4618	32	4 GB、1600 Mhz DDR4 RDIMM
	78P4620	32	8 GB、1600 MHz DDR4 RDIMM
	78P4621	32	16 GB、1600 MHz DDR4 RDIMM
	78P4622	32	32 GB、1600 MHz DDR4 RDIMM

その他のシステム部品 (空冷システム)



P8EIO512-2

図 3. その他のシステム部品 (空冷システム)

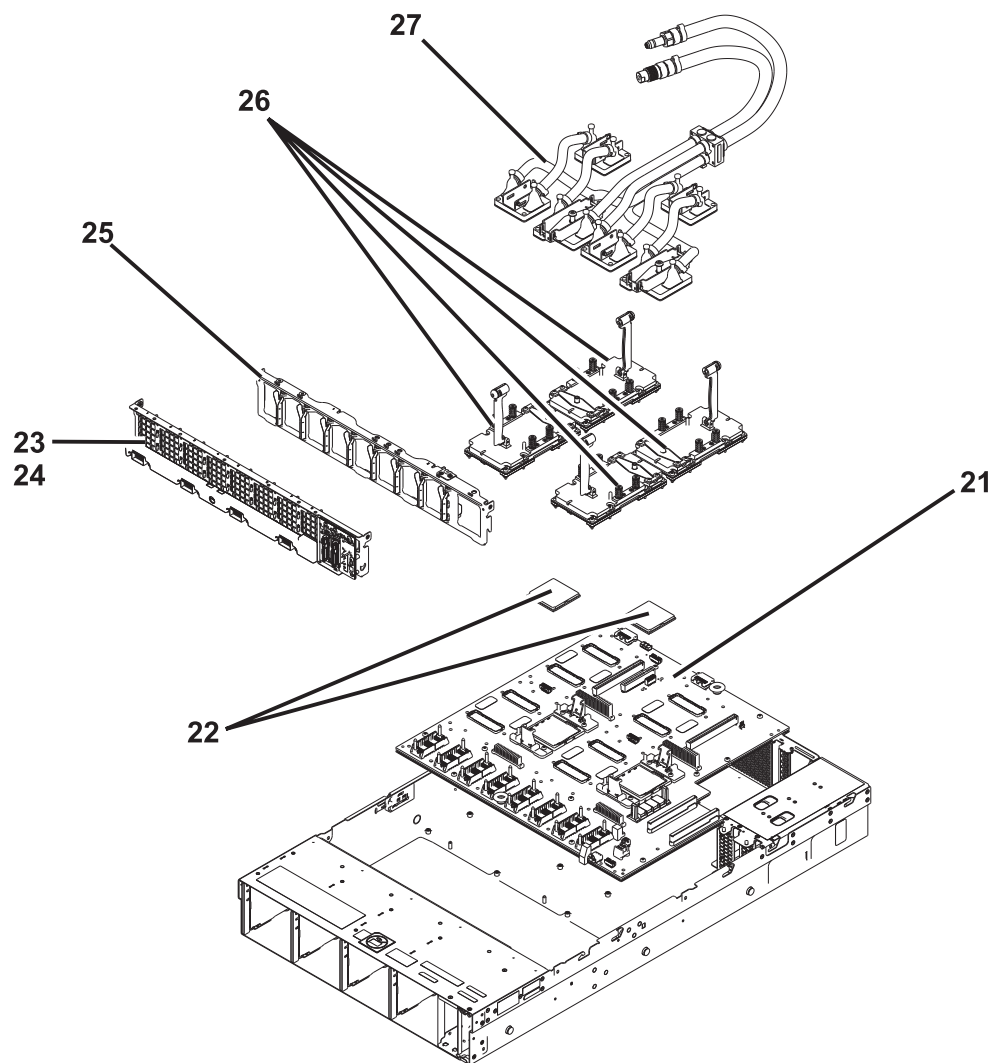
表 3. その他のシステム部品 (空冷システム)

索引番号	部品番号	アセンブリー当たりのユニット数	説明
18		2	グラフィックス処理装置 (GPU) エア・バッフル
19	01EM024	2	背面 GPU キット (GPU カード、エア・バッフル、ヒート・シンク、および熱伝導材料 (TIM) を含む)
20	01EM025	2	前面 GPU キット (GPU カード、エア・バッフル、ヒート・シンク、および TIM を含む)
21	00E4570	1	システム・バックプレーン・キット (モジュール取り外しツール、4 mm 六角棒スパナ、磁気ドライバー、エア・ポンプ、および蓋取り外しツールを含む)

表 3. その他のシステム部品 (空冷システム) (続き)

索引番号	部品番号	アセンブリー当たりの ユニット数	説明
22	00E5185	2	8 コア 3.259 GHz システム・プロセッサ・モジュール・キット (システム・プロセッサ・モジュール、プロセッサ・トレイ、4 mm 六角棒スパナ、モジュール交換ツール、およびエア・ポンプを含む)
	00E5187	2	10 コア 2.860 GHz システム・プロセッサ・モジュール・キット (システム・プロセッサ・モジュール、プロセッサ・トレイ、4 mm 六角棒スパナ、モジュール交換ツール、およびエア・ポンプを含む)
23	01AF227	2	システム・プロセッサ・ヒート・シンク・キット (ヒート・シンクおよび TIM を含む)
24	01AF227	2	システム・プロセッサ・ヒート・シンク・キット (ヒート・シンクおよび TIM を含む)
25	00E5128	1	ディスク・ドライブおよびファン・カード
26	00E4476	1	ねじキット 注: ねじキットには、ディスク・ドライブとファン・カード用のねじ 12 本、およびシステム・バックプレーン用のねじ 16 本が含まれています。
27		1	システム・バックプレーンの中間サポート

追加のシステム部品 (水冷システム)



P8EIO513-1

図 4. 追加のシステム部品 (水冷システム)

表 4. 追加のシステム部品 (水冷システム)

索引番号	部品番号	アセンブリー当たりのユニット数	説明
21	00E4570	1	システム・バックプレーン・キット (モジュール取り外しツール、4 mm 六角棒スパナ、磁気ドライバー、エア・ポンプ、および蓋取り外しツールを含む) 注: 水冷 8335-GTB のシステム・バックプレーン・キットを取り替える場合は、システム・プロセッサ TIM 交換キット (01EM029) および水冷システム・バックプレーン・キット (01EM030) も必要です。水冷システム・バックプレーン・キット (01EM030) は、既にお持ちであれば必要ありません。

表 4. 追加のシステム部品 (水冷システム) (続き)

索引番号	部品番号	アセンブリー当たりの ユニット数	説明
22	00E5185	2	8 コア 3.259 GHz システム・プロセッサ・モジュール・キット (システム・プロセッサ・モジュール、プロセッサ・トレイ、4 mm 六角棒スパナ、モジュール交換ツール、およびエア・ポンプを含む)
	00E5187	2	10 コア 2.860 GHz システム・プロセッサ・モジュール・キット (システム・プロセッサ・モジュール、プロセッサ・トレイ、4 mm 六角棒スパナ、モジュール交換ツール、およびエア・ポンプを含む)
23	00E5128	1	ディスク・ドライブおよびファン・カード
24	00E4476	1	ねじキット 注: ねじキットには、ディスク・ドライブとファン・カード用のねじ 12 本、およびシステム・バックプレーン用のねじ 16 本が含まれています。
25		1	システム・バックプレーンの中間サポート
26	01EM027		水冷 GPU キット (スプレッダー・アセンブリー、GPU カード、エア・バッフル、ヒート・シンク、および TIM を含む)
27	01AF969	1	冷却プレート・アセンブリー (冷却プレート、ピンセット、および TIM を含む)

各種部品

表 5. 各種のシステム部品

説明	部品番号	アセンブリー当たりのユニット数
システム・プロセッサ TIM 交換キット (TIM 取り外しツール、ピンセット、および TIMを含む)	01EM029	1
水冷システム・バックプレーン・キット (冷却プレートおよびモジュール・トレイを含む)	01EM030	1

背面ポート

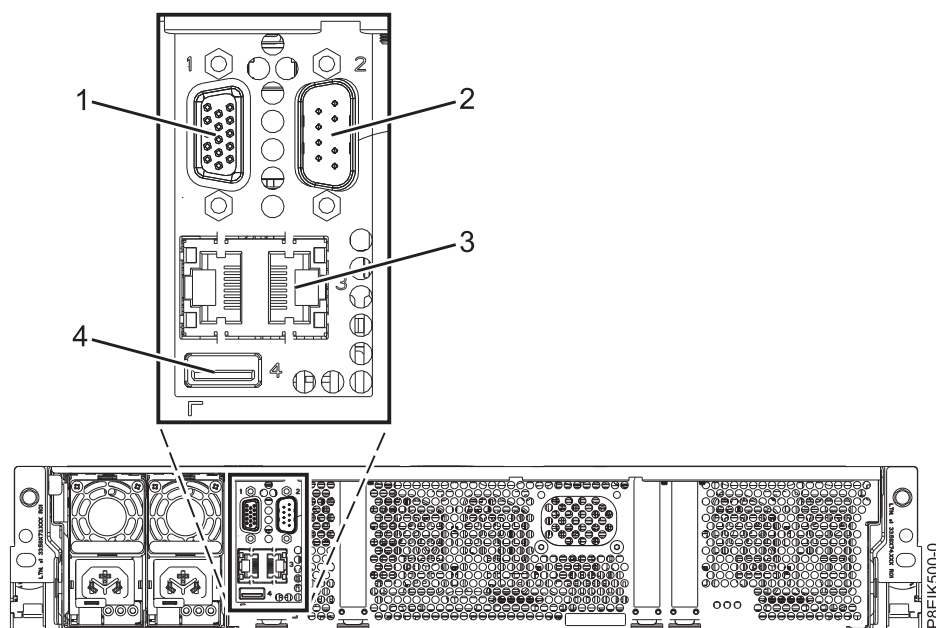


図 5. ポートが表示されているシステムの背面図

表 6. ポートの説明

ID	説明
1	Video Graphics Array (VGA)。現時点でサポートされているのは、テキスト・ベース機能のみです。
2	インテリジェント・プラットフォーム管理インターフェース (IPMI) (Intelligent Platform Management Interface (IPMI)) シリアル
3	イーサネット。左側のイーサネット・ポートを BMC/IPMI インターフェースに使用します (eth0 として)。右側のイーサネット・ポートを任意の直接 OS 用途に使用します (eth1 として)。
4	USB 3.0

IBM Power System S812LC (8335-GTB) 部品の取り付けと取り外し

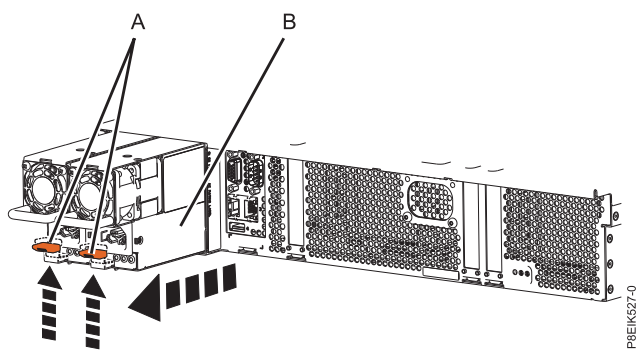


図 6. システムから電源装置を取り外す

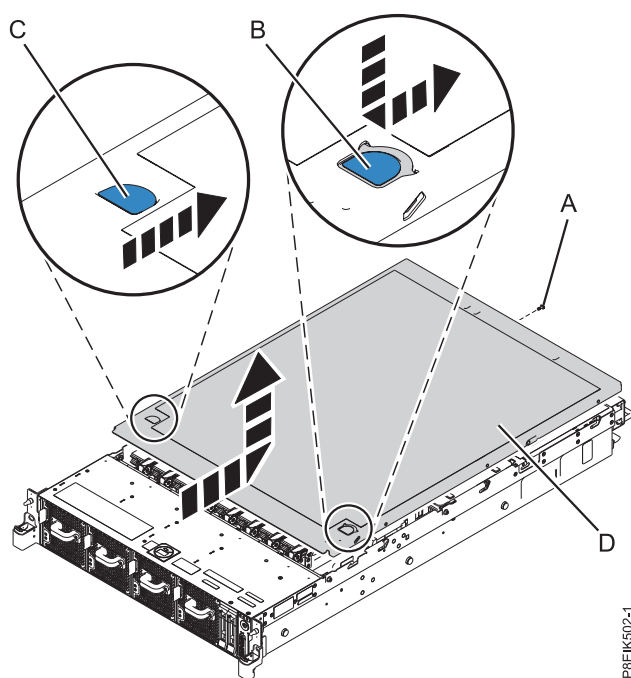


図 7. カバーの取り外し

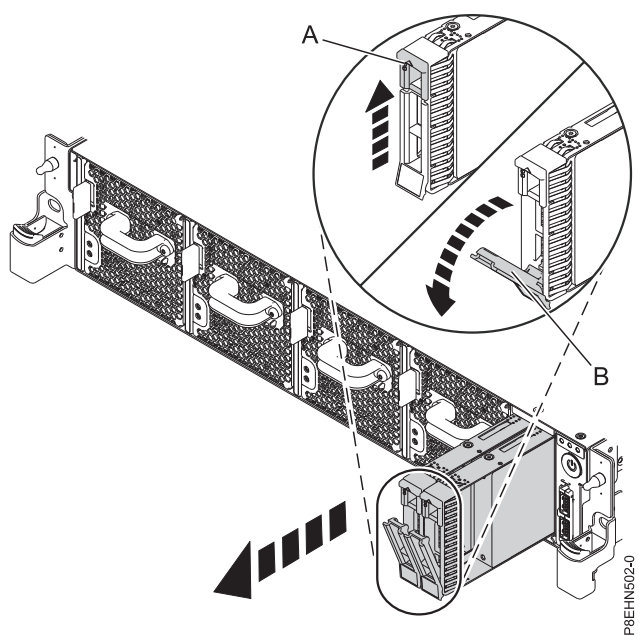


図 8. ディスク・ドライブのロックの詳細

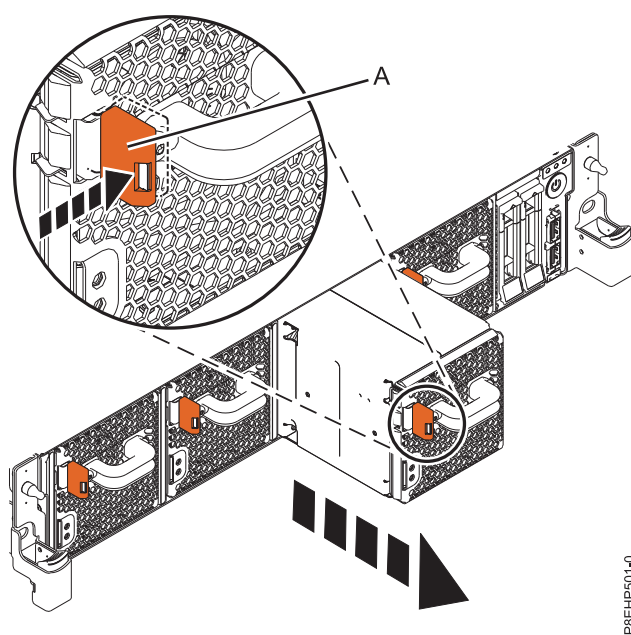


図 9. システムからのファンの取り外し

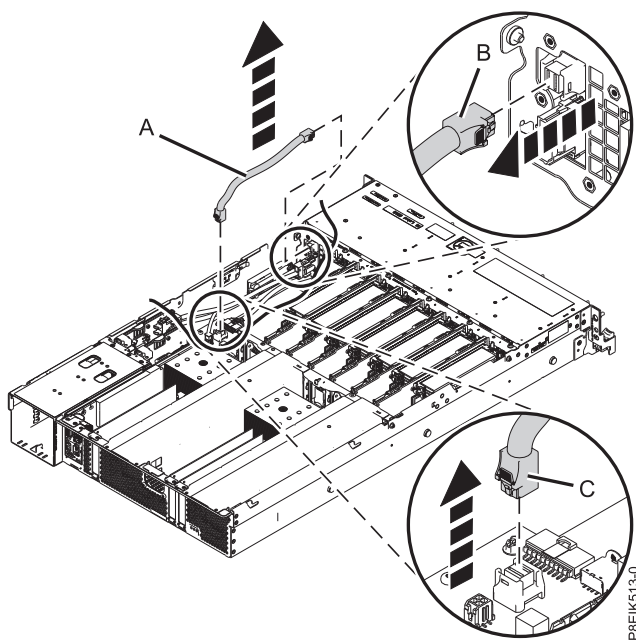


図 10. ディスクおよびファン信号ケーブルの取り外し

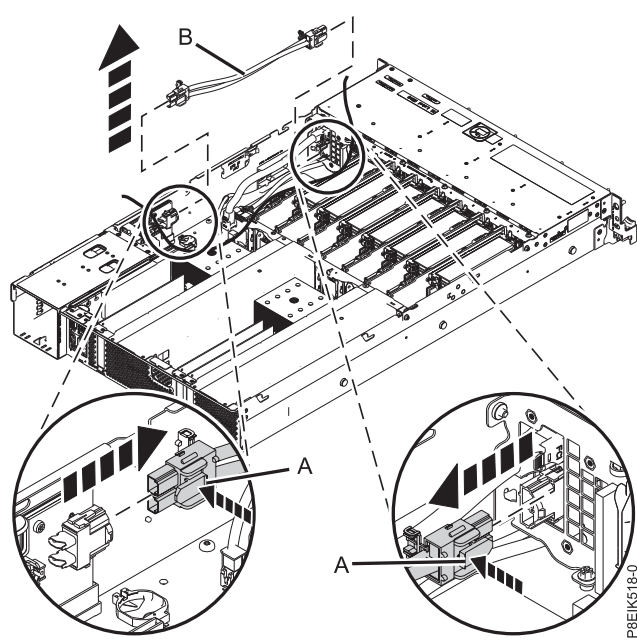


図 11. システムからのファン電源ケーブルの取り外し

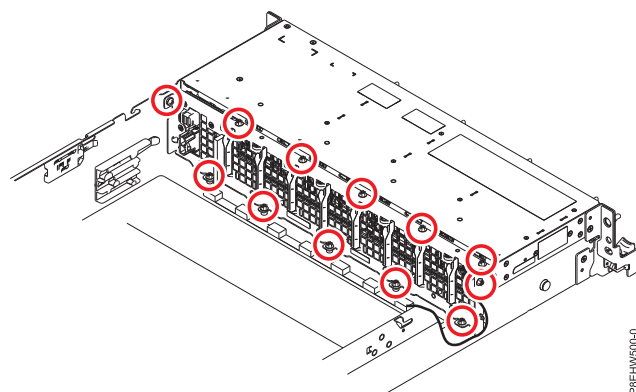


図 12. ディスク・ドライブおよびファン・カードのねじの位置

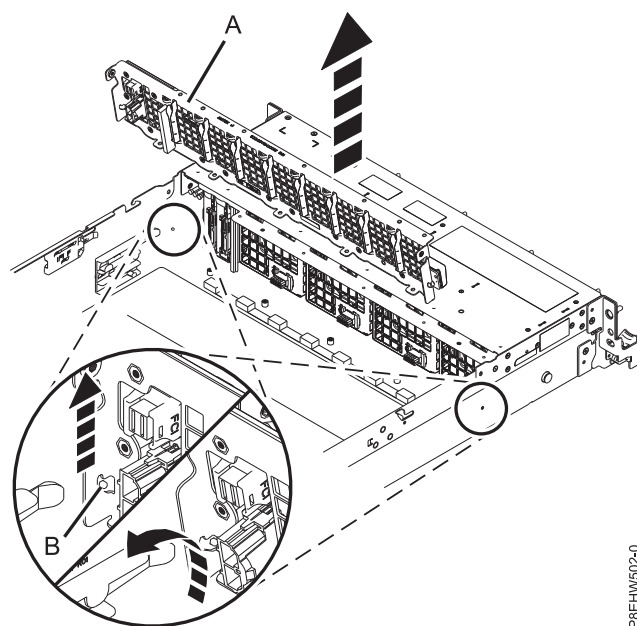


図 13. ディスク・ドライブおよびファン・カードの取り外し

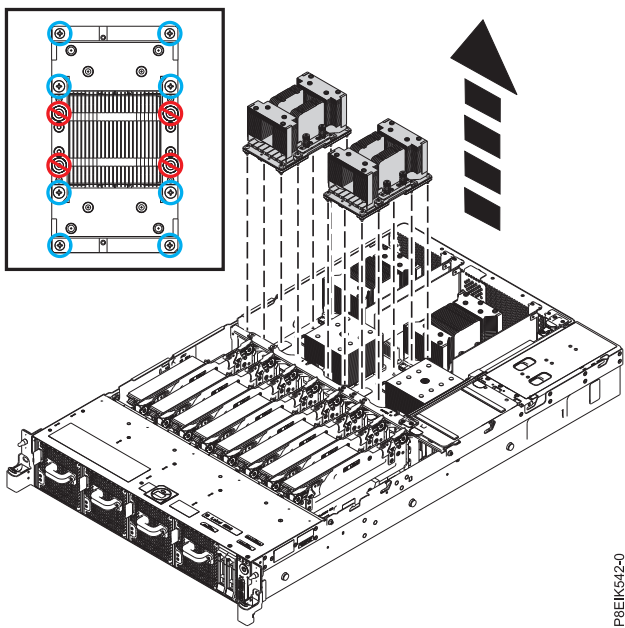


図 14. 1 つの GPU につき 8 本のねじの取り外し (4 本のばね付きねじは緩めない)

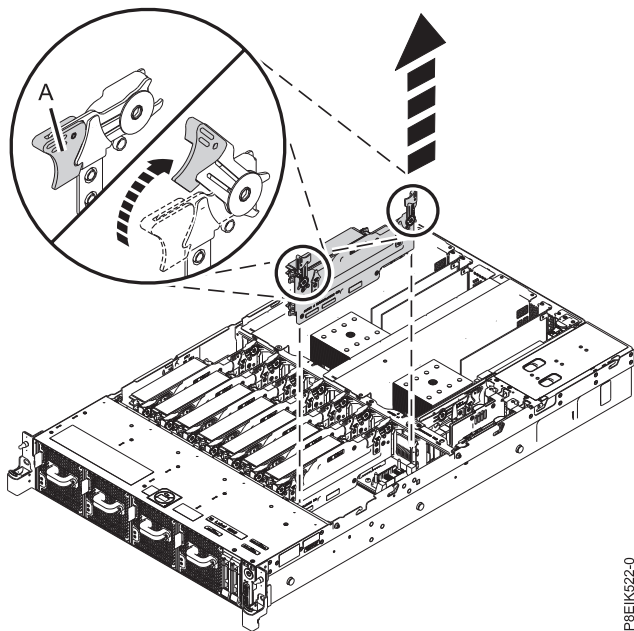


図 15. システムからのメモリー・ライザーの取り外し

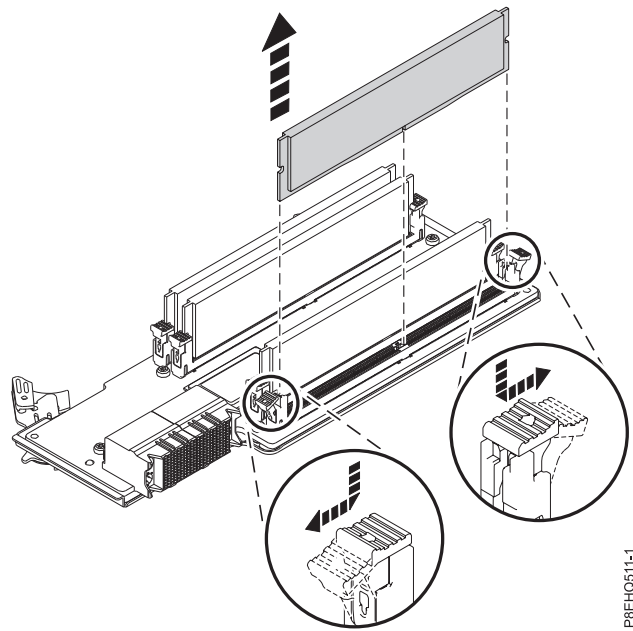


図 16. ライザー上のスロットからのメモリー DIMM の取り外し

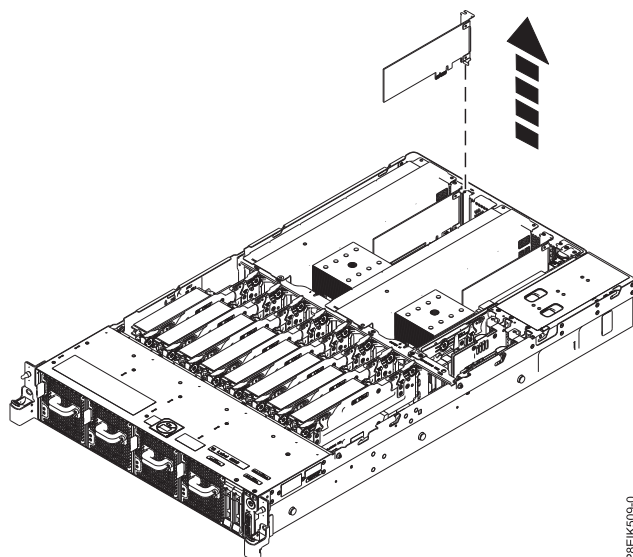


図 17. PCIe アダプターの取り外し

P8EIK509-0

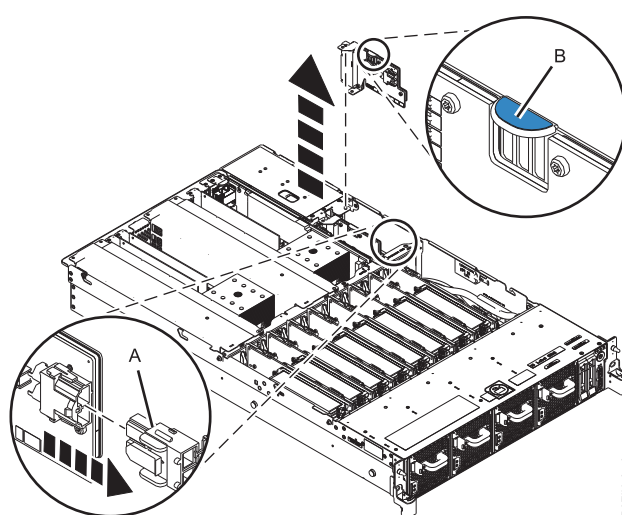


図 18. システムからの電源ライザーの取り外し

P8EIK525-0

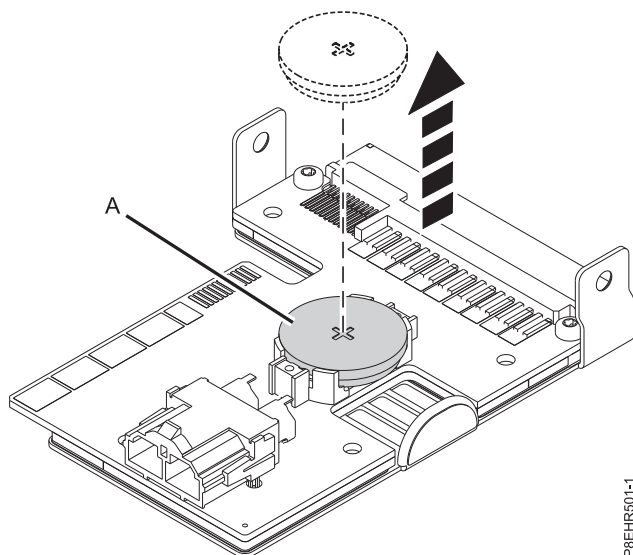


図 19. 電源ライザーからの時刻バッテリーの取り外し

P8EHR501-1

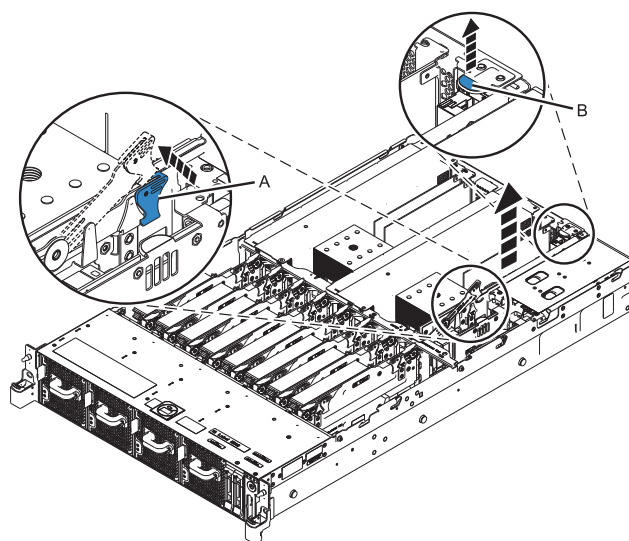


図 20. BMC カード の取り外し

P8EIK549-0

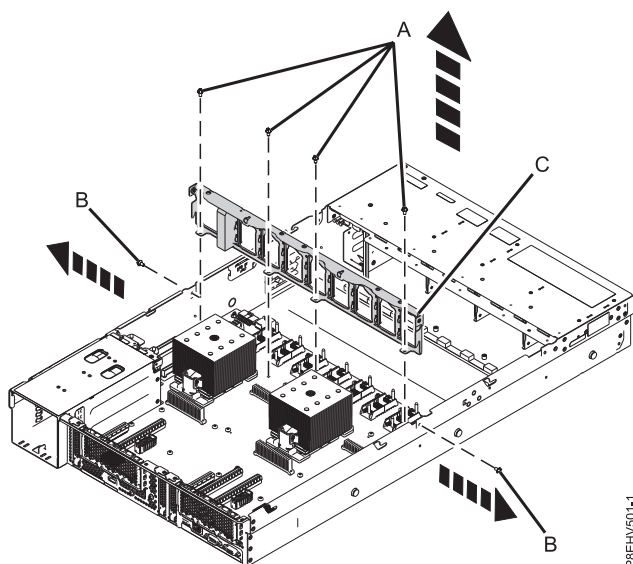


図 21. 中間サポートの取り外しおよびねじの位置

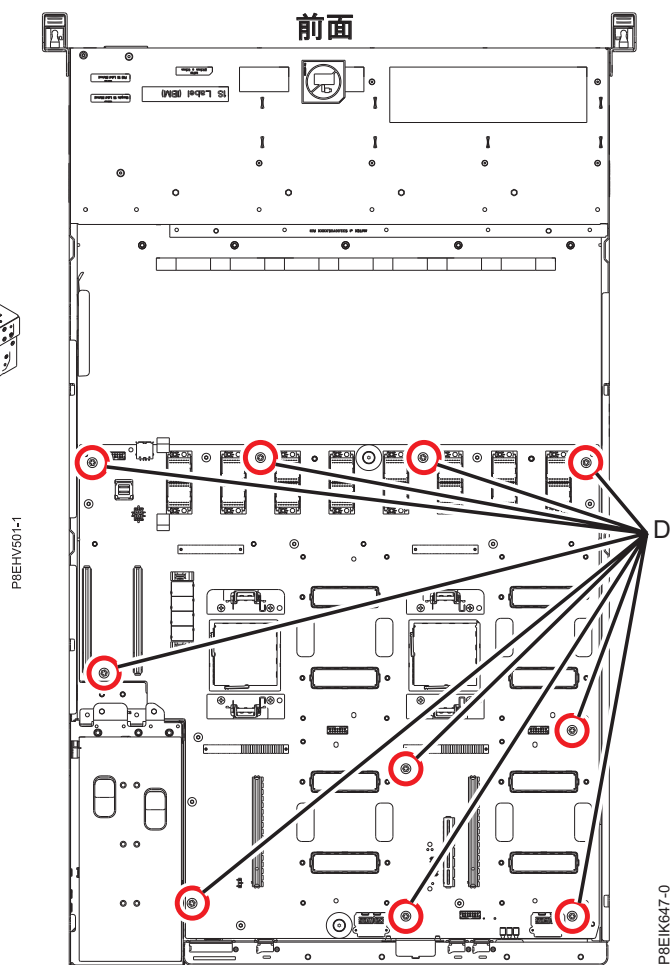


図 22. システム・バックプレーンのねじの位置

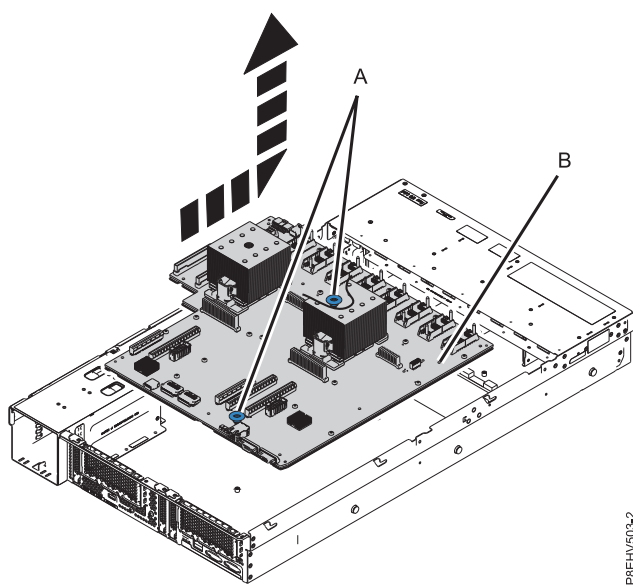


図 23. システム・バックプレーンを持ち上げて外す

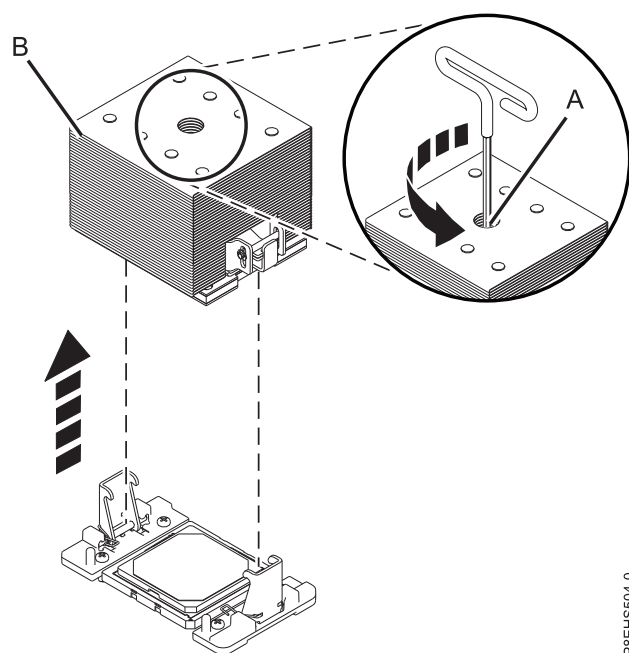


図 24. ヒート・シンクの取り外し

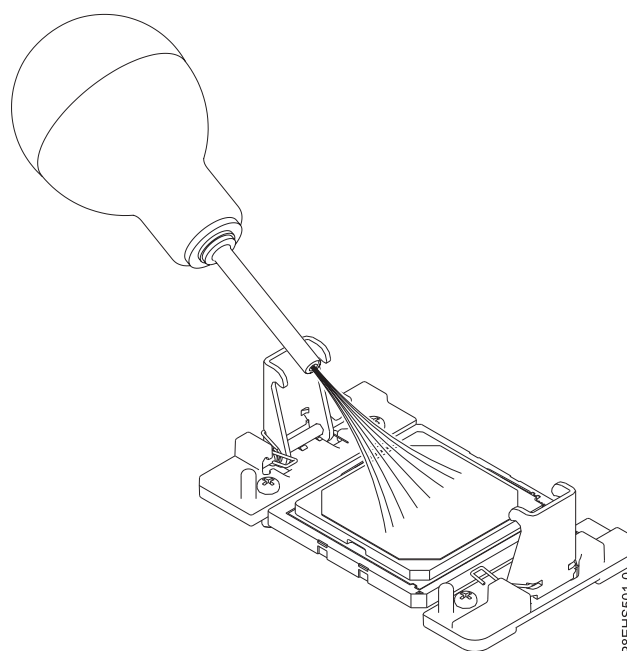


図 25. システム・プロセッサ・モジュールの領域からほこりやごみを除去

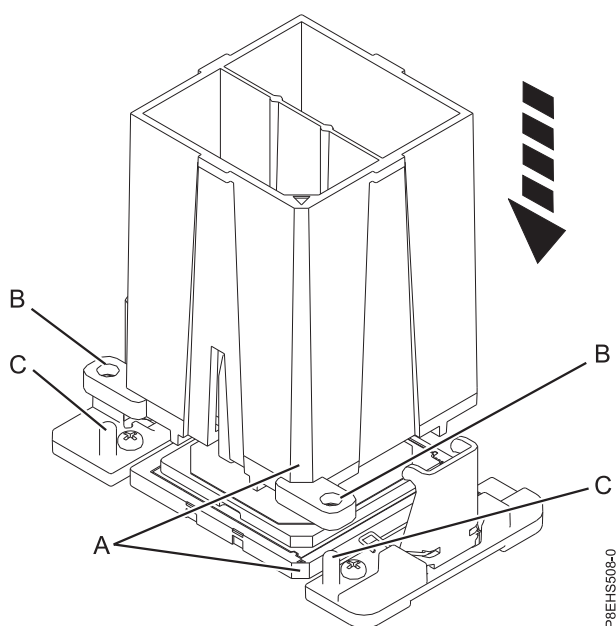


図 26. 取り外しツールをシステム・プロセッサ・モジュールの上に下ろす

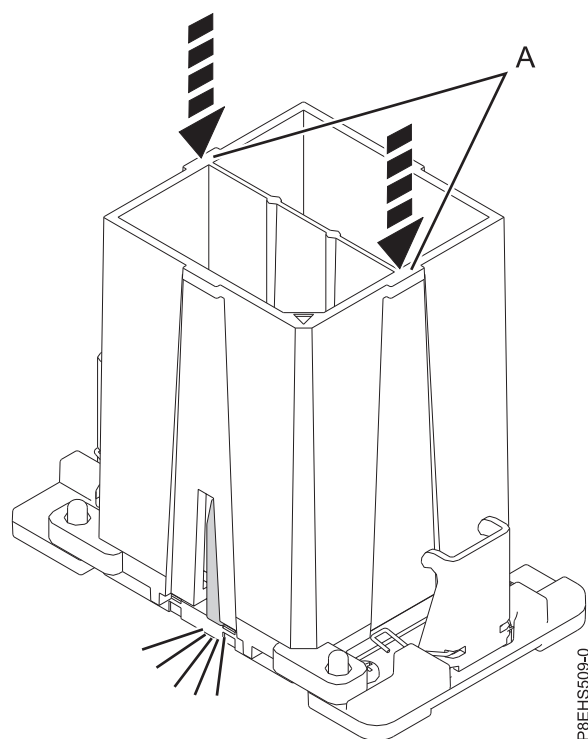
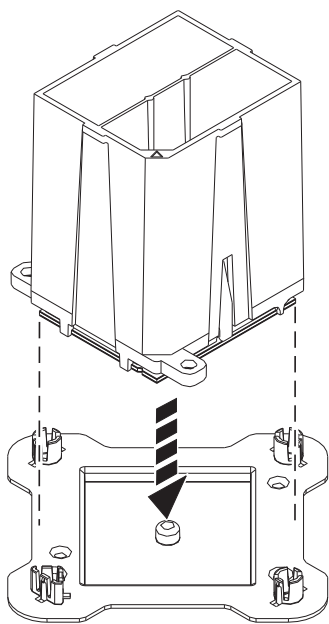
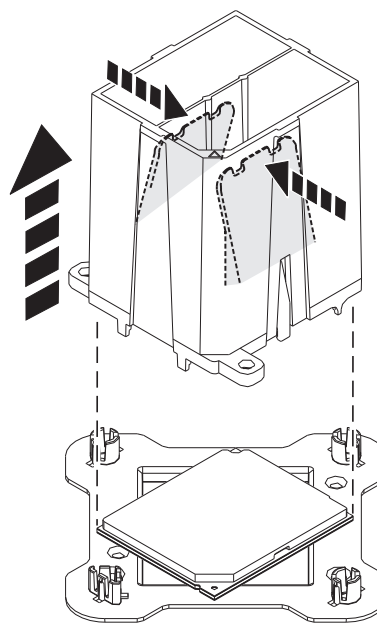


図 27. システム・プロセッサ・モジュールをツールにロック



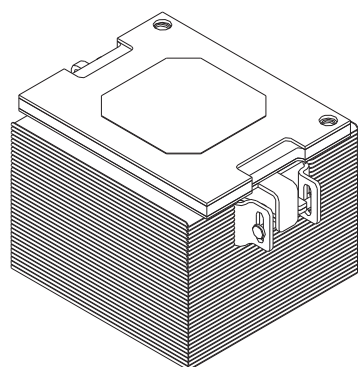
P8EDE521-1



P8EDE522-1

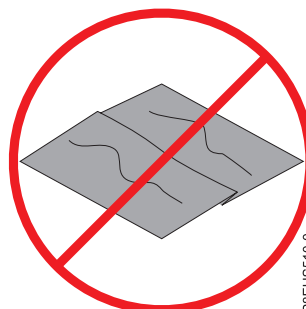
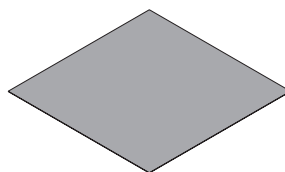
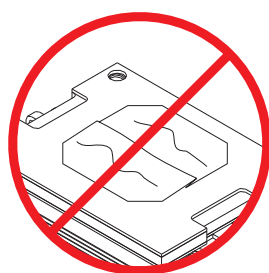
図 28. パッケージのトップ・カバーにツールを斜めに置く
熱伝導材料が損傷している場合は、取り替えます。

図 29. ツールからのシステム・プロセッサ・モジュール
の解放



P8EHS502-0

図 30. 銀色の熱伝導材料の検査



P8EHS510-0

図 31. グレーの熱伝導材料の検査

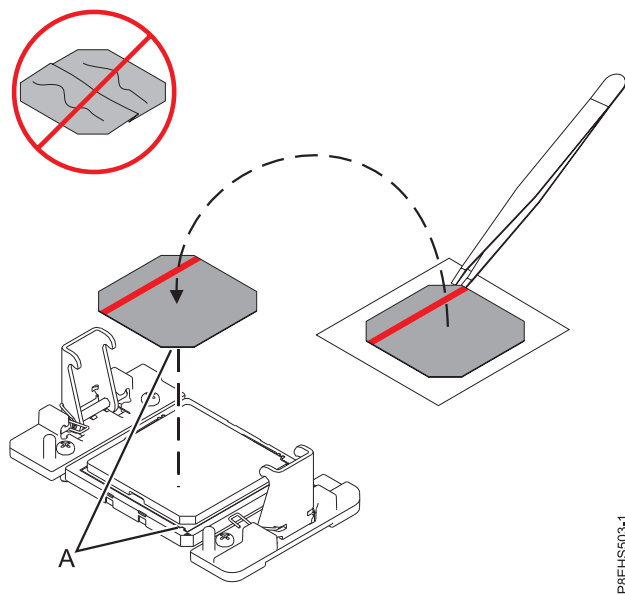


図 32. プロセッサへの銀色の TIM の取り付け

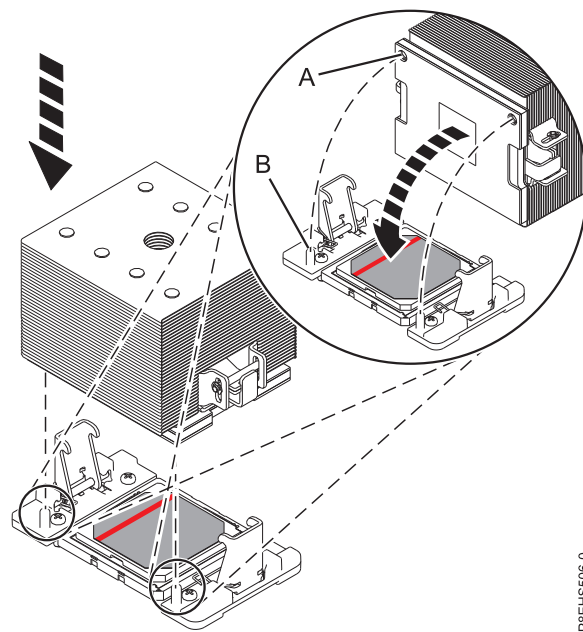


図 33. 銀色の TIM への新規ヒート・シンク取り付け

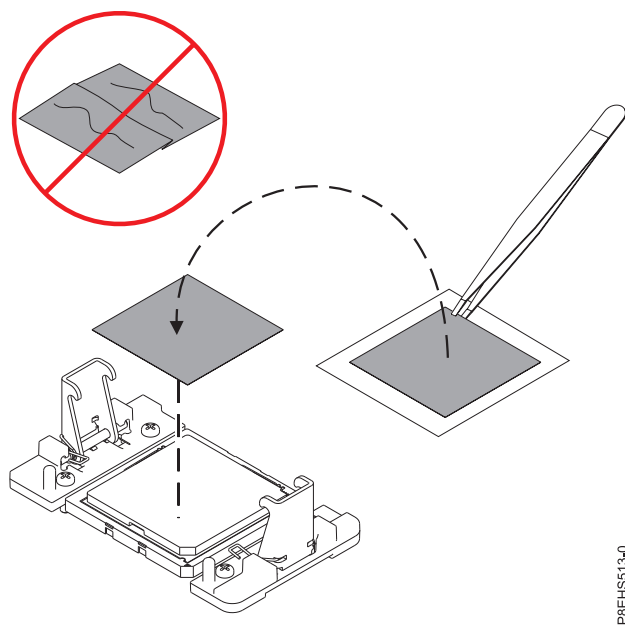


図 34. プロセッサへのグレーの新規 TIM の取り付け

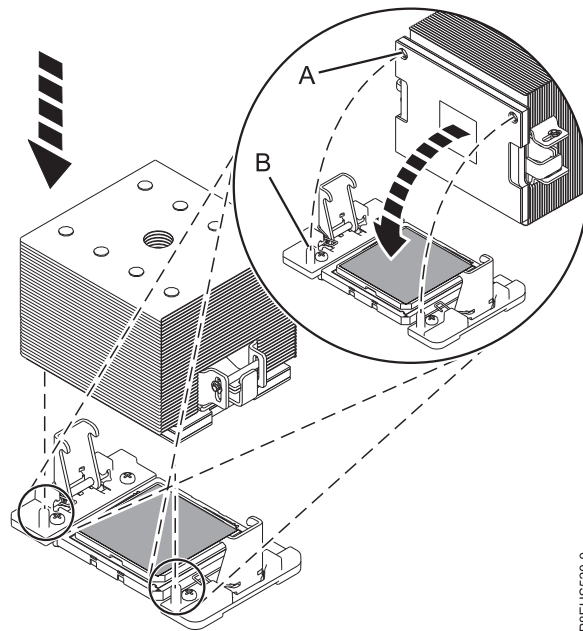
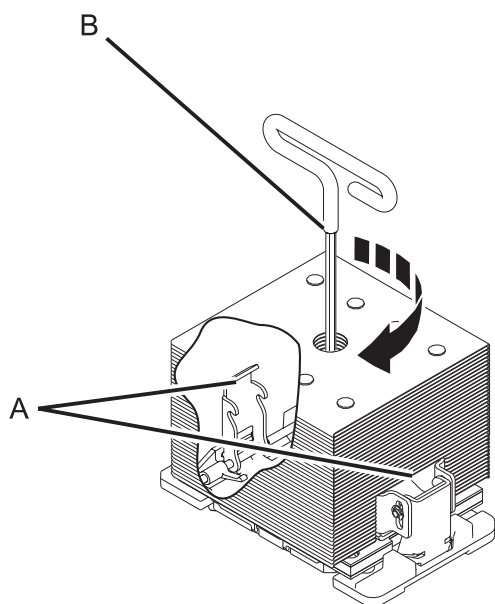
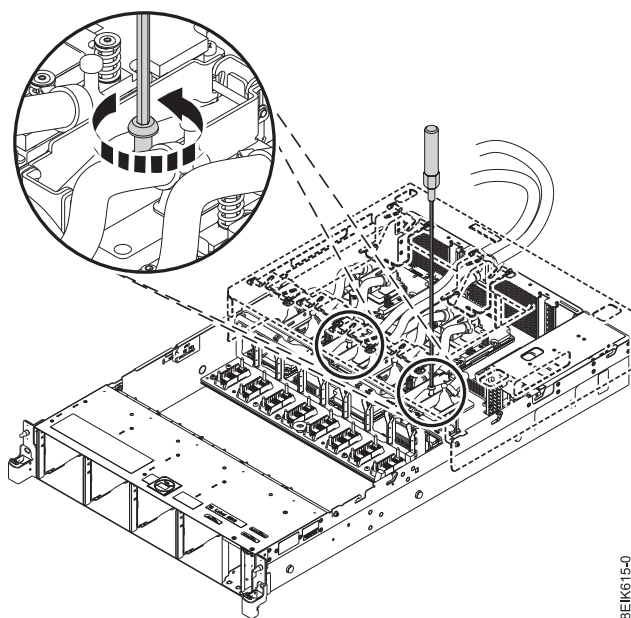


図 35. グレーの TIM へのヒート・シンク取り付け



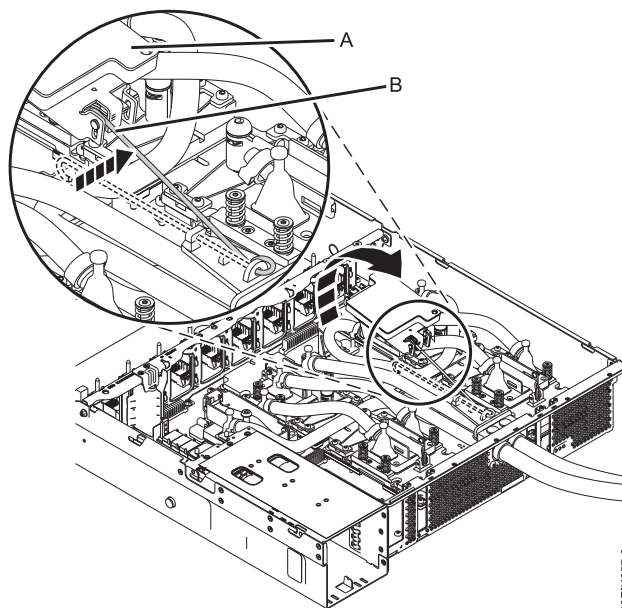
P8EHS507-0

図 36. ヒート・シンク上の中央にあるロードねじの締め付け



P8EIK615-0

図 37. 冷却プレートの保持ねじを緩める



P8EIK657-0

図 38. 冷却プレートの取り外し

本書は、POWER8 プロセッサを搭載した IBM Power Systems サーバーおよびすべての関連モデルに適用されます。

本装置は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 に適合しています。

本製品およびオプションに電源コード・セットが付属する場合は、それぞれ専用のものになっていますので他の電気機器には使用しないでください。本体機器提供後に、追加で電源コード・セットが必要となった場合は、補修用の取扱いとなります。

© Copyright IBM Corporation 2016, 2017.